

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和5年4月18日(2023.4.18)

【公開番号】特開2022-50210(P2022-50210A)

【公開日】令和4年3月30日(2022.3.30)

【年通号数】公開公報(特許)2022-056

【出願番号】特願2020-156679(P2020-156679)

【国際特許分類】

H 01 L 21/68 (2006.01)

10

H 01 L 21/677 (2006.01)

B 25 J 9/10 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 F

H 01 L 21/68 A

B 25 J 9/10 A

【手続補正書】

【提出日】令和5年4月10日(2023.4.10)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0071

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0071】

ここで、計測位置P1は、基板Wがセンサ61を遮ることで基板Wの外縁を検出する位置である(センサ61の遮光位置)。この位置において、経路101と経路201とは一致している。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

30

【補正対象項目名】0074

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0074】

ここで、センサ6は、搬送機構5の動作(経路)に依存しない位置で基板Wの外縁を検出する。即ち、図9に示す例において、センサ6は、センサ61の遮光位置とセンサ62の投光位置に基づいて、基板Wの中心位置を算出する。これにより、計測位置P1から目標位置P2までの搬送機構5の伸縮動作にいたる直前の動作(経路101, 201)が異なることにより、計測位置P1から目標位置P2までの動作(経路102, 202)が異なっていたとしても動作依存のない位置で基板Wの外縁を検出することができる。

これにより、同一のキャリブレーションデータを用いても、センサ6を用いて基板Wの中心位置と基準位置とのずれ量を算出する際の精度を向上させることができる。また、基板Wを目標位置まで搬送する際の搬送精度を向上させることができる。

40

50